

भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
यू.आर. राव उपग्रह केंद्र /U.R.RAO SATELLITE CENTRE
एच.ए.एल. एयरपोर्ट रोड, विमानापुरा डाक/HAL Airport Road, Vimanapura Post,
बेंगलूरु/BENGALURU – 560 017

Ref No.: ISII 2025-0-66493

19.01.2026

आर एफ कुंडली एवं चिप प्रेरकों के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति
(ई ओ आई) के लिए आमंत्रण- के संबंध में।
Invitation for Expression of Interest [Eoi]
for RF Coil and Chip Inductors -Reg

यू.आर.राव उपग्रह केंद्र (यू.आर.एस.सी), (पूर्व में इसरो उपग्रह केन्द्र के रूप में जाना जाता था) सभी भारतीय उपग्रहों की अभिकल्पना, विकास, संविचन तथा परीक्षण के लिए भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का अग्रणी केंद्र है। वर्तमान में यू आर एस सी अंतरिक्ष उपयोग हेतु उत्पादन, स्क्रीनिंग, अर्हता और आर एफ कुंडली एवं चिप प्रेरकों के लिए स्वदेशी उद्योग भागीदारों को आमंत्रित करता है।

U. R. Rao Satellite Centre [URSC] (Formerly known as ISRO Satellite Centre), of Indian Space Research Organization [ISRO] under Department of Space, Government of India is responsible for Design, Development, Fabrication and Testing of all Indian made Satellites. URSC is currently inviting indigenous Industry Partners for manufacturing, Screening, Qualification and supply of RF Coil and Chip Inductors for space applications.

केवल उन भारतीय उद्योगों से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने का प्रस्ताव है जिनके पास प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा आर एफ कुंडली एवं चिप प्रेरकों का अभिकल्प, विकास, उत्पादन एवं परीक्षण करने की क्षमता है। ऐसे विक्रेता जो स्वीकार योग्य अंतरिक्ष श्रेणी के आर एफ कुंडली एवं चिप प्रेरक को सुपुर्दगी करना चाहते हैं वे इसके लिए प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आर एफ कुंडली एवं चिप प्रेरक की आवश्यकताओं को इस दस्तावेज के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

This proposal is to invite Expression of Interest exclusively from Indian industries having technical infrastructure and capability for design, development, manufacturing and Testing of RF Coil and Chip Inductors & are ready to perform qualification. Those vendors which are interested to qualify & deliver the acceptable space grade RF Coil and Chip Inductors may respond to this enquiry. The requirements of RF Coil and Chip Inductors are attached as Annexure to this document.

इस संबंध में, यू आर एस सी, ऐसे भारतीय उद्योग/विक्रेताओं से इच्छा की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) का आमंत्रण करता है जिनके पास पूर्ण रूप से स्थापित आर एफ कुंडली एवं चिप प्रेरक का उत्पादन तथा परीक्षण सुविधा है या उसको स्थापित कर रहे हैं और यू आर एस सी को स्वीकार योग्य अंतरिक्ष श्रेणी के आर एफ कुंडली तथा चिप प्रेरक की सुपुर्दगी कर सकते हैं।

In this regard, URSC invites the Expression of Interest [Eoi] from Indian Industries/Vendors who have or are in the process of establishing full-fledged RF Coil and Chip Inductors Manufacturing and Testing Facility and deliver the acceptable Space Grade RF Coil and Chip Inductors to URSC.

ई ओ आई का मूल्यांकन बोलीकर्ताओं के अनुभव, कार्यक्षेत्र की जानकारी, सुविधा अवसंरचना, प्रस्तावित कार्यप्रणाली एवं कार्य योजना, कुशल जनशक्ति और उद्योग की वित्तीय सुदृढ़ता के आधार पर किया जाएगा।

The EOI will be evaluated on the basis of bidder's experience, understanding of scope of work, facility infrastructure, proposed methodology and work plan, skilled manpower and the financial strength of the industry.

यू.आर.एस.सी आवश्यकता पड़ने पर ई.ओ.आई. की प्रक्रिया रद्द करने या अतिरिक्त सूचनाएँ/ब्यौरे मांगने के लिए इसे पुनः जारी करने का अधिकार रखता है।

URSC reserves the right to cancel/re-issue the process of EOI if the necessity so arises or to seek further information/details.

किसी भी प्रकार की भ्रष्ट या कपटपूर्ण गतिविधियों में लिप्त पाई गई कंपनियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा और उनके ई ओ आई दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा।

Companies/Firms, if found to have indulged in any corrupt or fraudulent practices, will be debarred taking part in the Tendering process and their EOI Document will not be taken up for consideration.

इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों को निम्नलिखित जानकारी भी विस्तार से प्रस्तुत करनी चाहिए:

Along with "Expression of Interest" Suppliers/ Firm[s] should furnish the following information also in detail:

1. कंपनियों का पंजीकृत पता के साथ, फोन, फैक्स, ई मेल, वेब आदि।
Registered address of the Companies with Phone, Fax, Email, Web, etc.
2. कंपनी/संगठन की स्थिति (स्वामित्व/साझेदारी/निजी/सार्वजनिक लिमिटेड आदि) के साथ मालिक, भागीदारों, निदेशक मंडल आदि के नाम और पता।
Company/Organization Status (Proprietary/Partnership/Private/Public Ltd. etc.) with Name and Address of Proprietor, Partners, Board of Directors, etc.
3. सहयोगी: (ए) भारतीय (बी) विदेशी।
Associates: (a) Indian (b) Foreign.
4. पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रमुख ग्राहकों के पूर्ण पता और उनके संपर्क व्यक्ति की सूची।
List of Major Customers during the last 3 Years with full address and their Contact Persons.
5. स्वामित्व वाली/उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं का विवरण।
Details of Infrastructure Facilities owned / available.
6. कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों के नाम और पते तथा उनकी शेयर पूंजी का प्रतिशत।
Names and addresses of the major Shareholders of the Company and the percentage of their share capital.
7. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए पूंजी और कारोबार।
Capital and Turnover for the preceding 3 Financial Years with copy of latest Annual Report.
8. उपलब्ध वित्तीय क्षमता /क्रेडिट सुविधाएं।
Financial Capacity/Credit facilities available.
9. बैंकरों का नाम , पता व खाता विवरण।
Name and Address of Bankers and Bank details
10. व्यापार संघ जिससे उद्योग जुड़ा/ जुड़े हैं।
Trade Association to which Industry/ies belong to.

11. संस्था/बिक्री/माल व सेवा कर पंजीकरण संख्या।
Establishment/Sales/Goods & Service Tax Registration Number.
12. व्यापार का प्रकार।
Nature of Business
13. कर्मचारियों की संख्या सहित संगठन की संरचना।
Organization structure along with no. of employees.
14. बैंकरों द्वारा जारी फर्म की सॉल्वेंसी/वित्तीय क्षमता।
Solvency/Financial capacity of the Firm issued by their Bankers.
15. उद्योगों की अन्य कोई प्रासंगिक जानकारीयाँ।
Any other information the Industry/ies consider relevant.
16. सामर्थ्य और कमियों के क्षेत्रों को स्पष्टतः प्रकट करते हुए कंपनी/कंपनियों के प्रोफाइल
The Profile of the Company/ies clearly bringing out the areas of Strength and Weakness.
17. ई ओ आई में भाग लेने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक सामर्थ्य का स्व-मूल्यांकन।
Self-Assessment on Technical and Organizational Competence to take part in the EOI.
18. ई ओ आई में उल्लिखित प्रत्युत्तर प्रपत्र
Response forms as mentioned in the Eoi.

ईओआई प्रतिक्रिया को पूरा करना /Completion of the EOI Response:

- a) ईओआई दस्तावेजों के सभी अनुदेशों: निबंधन और शर्तों: प्रपत्रों: आवश्यकताओं और अन्य सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की कंपनी/ फर्म को सलाह दी जाती है। ईओआई दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद इसके निहितार्थों को पूरी तरह समझ कर ईओआई प्रस्तुत करना पड़ेगा।
The Company/Firms are advised to study all the instructions; Terms and Conditions; Forms; Requirements and other information in the EOI documents carefully. The submission of EOI shall be deemed to have been done after a careful study and examination of the EOI documents with full understanding of its implications.
- b) इस ई ओ आई का जवाब सभी मामलों में पूर्ण और संपूर्ण होना चाहिए। ई ओ आई दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या ईओआई दस्तावेजों के हर पहलू के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी न होने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कंपनी/फर्म के जोखिम पर होगा और इसके परिणामस्वरूप दस्तावेज को अस्वीकार किया जा सकता है।
The response to this EOI should be full and complete in all respect. Failure to furnish all the information required by the EOI document or submission of proposal not substantially responsive to the EOI documents to every aspect will be at the risk of the Company/Firms and may result in rejection of the document.
- c) प्रस्तुत किए गए ईओआई के सभी पृष्ठों पर क्रमांक होनी चाहिए और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
All the pages of the EOI submitted must be numbered and signed by the authorized signatory.
- d) ई ओ आई के संबंध में प्रचार करना सख्त वर्जित है और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रचारित ईओआई को अस्वीकार किया जा सकता है।

Canvassing in connection with the EOI be strictly prohibited and such canvassed EOI submitted by the Agency are liable to be rejected.

क्रियाकलापों को अच्छी तरह समझने और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण करने हेतु यू आर राव उपग्रह केन्द्र द्वारा एक पूर्व ई ओ आई बैठक का आयोजन किया जाएगा। तदुपरांत, आरएफपी में मांगे गए विवरण के साथ विक्रेताओं को इच्छा की अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना होगा।

A Pre-Eoi meeting will be arranged by U.R. Rao Satellite Centre, Bengaluru in order to have a better understanding of the activities involved, clarify doubts, if any. Subsequently, the vendor(s) shall submit the response to Expression of Interest along with the details sought in RFP.

विनिर्दिष्ट दिनांक के पहले पूर्व बोली बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के विवरण सुरक्षा स्वीकृति का प्रबंध करने हेतु तालिका – 1 में विनिर्दिष्ट संपर्क व्यक्ति को कृपया उपलब्ध करें। विक्रेता के प्रतिनिधि को पूर्व ई – ओ आई बैठक में भाग लेने हेतु “प्राधिकार पत्र” लाना होगा। बोली लगाने वाले/कंपनी/संगठन से सदस्य प्रतिनिधि की संख्या अत्यधिक केवल दो (2) (एक तकनीकी तथा एक वित्तीय) तक सीमित होना चाहिए।

Interested Vendor[s] may please provide the details of the representative[s] taking part in the Pre-Eoi meeting well in advance prior to dates specified in Table-1 to the Focal Point in order to arrange for Security clearance. Vendor[s] representative shall carry an “Authorization Letter” for attending the Pre-Eoi meeting. Member Representative shall be limited to maximum of two (2) per bidder/ company/ organization.

विक्रेता द्वारा पूर्व ई ओ आई पूछताछ, पूर्व बैठक की दिनांक के 05 दिन पहले bsdivya@ursc.gov.in को एक प्रति अंकित करते हुए यू आर एस सी की ई मेल आई डी psf@ursc.gov.in पर पहुँचना चाहिए। कृपया नोट करें कि किसी भी परिस्थिति में, पूर्व ई ओ आई के लिए पूर्व/स्थगन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

Pre-EOI Queries from vendor [s] shall reach URSC 5 days prior to date of Pre-EOI meeting to e-mail ID: psf@ursc.gov.in marking a copy to bsdivya@ursc.gov.in. Please note that request for “Pre-ponement/postponement of Pre-Eoi meeting” will not be entertained under any circumstances.

उपरोक्त सभी जानकारी के साथ इच्छा की अभिव्यक्ति नीचे दिए गए पते पर, उपरोक्त संदर्भ संख्या का उल्लेख करते हुए, नियत तिथि और समय तक पहुँच जानी चाहिए।

“Expression of Interest” with all the above information shall reach the address given below, quoting the above Reference Number on or before the due date & time.

वरिष्ठ प्रधान, क्रय व भंडार/Sr. Head, Purchase & Stores

यू आर राव उपग्रह केंद्र/U R Rao Satellite Centre

एचएएल एयरपोर्ट रोड/HAL Airport Road

विमानपुरा पोस्ट, बेंगलुरु / Vimanapura Post, Bengaluru-560 017

कर्नाटक, भारत/Karnataka, India

कृपया ई ओ आई बैठक संख्या का उल्लेख करते हुए अपने स्पष्टीकरण bsdivya@ursc.gov.in को अंकित करते हुए psf@ursc.gov.in मेल पर भेजें। पूर्व ई ओ आई बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध

17.02.2026(मंगलवार) 16:00 बजे IST या उससे पहले यहाँ उल्लिखित ई-मेल पर पहुँच जाना चाहिए। तथापि ई ओ आई का जवाब (हार्डकॉपी) केवल ऊपर उल्लिखित डाक पते पर ही भेजा जाएगा। ई मेल व फैक्स कोटेशन स्वीकार्य नहीं हैं। नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार्य नहीं हैं। Please address your clarifications quoting the EOI number to e-mail: psf@ursc.gov.in marking a copy to bsdivya@ursc.gov.in. Request for participation in Pre-EOI meeting shall reach on or before **17.02.2026 (Tuesday) 16:00 Hrs IST** to the e-mail ids mentioned herein. However, response to EOI (hardcopy) shall be sent to above mentioned postal address only. E-mail & Fax quotations are not acceptable. Quotation received after due date & time are not acceptable.

तालिका /Table 1:

ई ओ आई विवरण की प्रस्तुति Submission of EOI Details	
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि Last date of submission of clarification	12.02.2026 16:00 Hrs IST
प्री-ईओआई बैठक (सम्मेलन कक्ष, स्वागत कक्ष, यू आर एस सी में): Pre-EOI meeting (at Conference Hall, Reception, URSC)	27.02.2026 10:00 Hrs IST
ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि Last date for submission of EOI	02.04.2026 14:00 Hrs IST
ई ओ आई की खुलने की तिथि Opening date of EOI	10.04.2026 14:00 Hrs IST

उपरोक्त सभी जानकारी के साथ इच्छा की अभिव्यक्ति **02.04.2026 @ 14:00 बजे IST** तक या उससे पहले उपरोक्त संदर्भ संख्या का उल्लेख करते हुए, नीचे अधोहस्ताक्षरी को पहुँच जानी चाहिए। यह प्रस्ताव पूर्व-ईओआई अर्हता के रूप में आरंभ किया गया है। यूआरएससी बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी ऐसी इच्छा की अभिव्यक्ति को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

“Expression of Interest” with all the above information shall reach the undersigned, Quoting above Reference Number on or before **02.04.2026 @14:00 Hrs IST**. This proposal is initiated as a Pre-EOI Qualification. URSC reserves the right to accept or reject all or any such “Expression of Interest” without assigning any reasons what so ever.

Sd/-

व. प्रधान, क्रय व भंडार /Sr. Head, Purchase & Stores

**INVITING EXPRESSION OF INTEREST [EoI]
FOR
DEVELOPMENT OF
RF Coil and Chip Inductors**

A. EoI OBJECTIVE

URSC invites the Expression of Interest [EoI] from Indian Industries who are having or in the process of establishing a full-fledged RF Coil and Chip Inductors Manufacturing and Testing Facility and deliver Space Grade RF Coil and Chip Inductors to URSC.

The purpose of this EoI is to invite proposals from potential vendors who are interested in developing Space Grade RF Coil and Chip Inductors for U. R. Rao Satellite Centre, Bengaluru. Vendors having sufficient know-how, experience, infrastructure to carry out manufacturing, screening & qualification and financial background shall submit the Expression of Interest [EoI].

Capable Vendors will be selected after evaluation of vendor's response, compliance & capability assessment by URSC from the list of vendors submitting the EoI.

B. QUALITY REQUIREMENT

The RF Coil and Chip Inductors offered shall meet the requirements of MIL-PRF-39010 and MIL-PRF-83446 respectively

C. COMPONENT SPECIFICATION

RF coil and Chip inductor details as per Annexure-1

D. VENDOR SELECTION

1. Vendors shall be submitted the details in the prescribed format outlined in **Annexure-2**.
2. Vendor shall submit the compliance for the products as prescribed in **Annexure-1**.
3. Vendor Selection will be based on the assessment of the vendor with respect to the vendor's capability, infrastructure, & experience in producing the proposed parts.
4. URSC team may conduct on-site visit to assess the vendor's capability & infrastructure.

E. GENERAL INFORMATION ON INDIGENISATION FLOW TO VENDORS

The Indigenization at URSC is carried out in phased manner is depicted in **Annexure-3** which is just an indicative flow of activities. The following are the phases involved:

1. Phase-1: Inviting Expression of Interest (EoI) from Vendors
2. Phase-2: Proto development by Vendor (Shortlisted in Phase-1 after EoI evaluation), proto submission to URSC & evaluation of prototypes by URSC
3. Phase-3: Production, Screening & Qualification of Indigenous parts by vendors (who's proto is declared successful in Phase-2)
4. Phase-4: Procurement of Indigenous parts from qualified & approved vendors for on-board applications
5. Qualification of Inductors needs efforts from Vendor & URSC, hence vendor is expected to maintain the production facility at least for 5 years after qualification for uninterrupted supply of space grade devices

F. LIST OF ENCLOSURES

1. **Annexure-1:** RF coil and chip inductor details
2. **Annexure-2:** Vendor Details Form
3. **Annexure-3:** Flow of Indigenization Activity

Vendor shall provide point to point compliance for the specification

Point to Point Compliance Matrix

SI No	Specification	Compliance (Yes/No)
A	EoI OBJECTIVE URSC invites the Expression of Interest [EoI] from Indian Industries who are having or in the process of establishing a full-fledged RF Coil and Chip Inductors Manufacturing and Testing Facility and deliver Space Grade RF Coil and Chip Inductors to URSC. The purpose of this EoI is to invite proposals from potential vendors who are interested in developing Space Grade RF Coil and Chip Inductors for U. R. Rao Satellite Centre, Bengaluru. Vendors having sufficient know-how, experience, infrastructure to carry out manufacturing, screening & qualification and financial background shall submit the Expression of Interest [EoI]. Capable Vendors will be selected after evaluation of vendor's response, compliance & capability assessment by URSC from the list of vendors submitting the EoI.	
B	QUALITY REQUIREMENT The RF Coil and Chip Inductors offered shall meet the requirements of MIL-PRF-39010 and MIL-PRF-83446 respectively	
C	COMPONENT SPECIFICATION RF coil and Chip inductor details as per Annexure-1	
D	VENDOR SELECTION 1. Vendors shall be submitted the details in the prescribed format outlined in Annexure-2 . 2. Vendor shall submit the compliance for the products as prescribed in Annexure-1 . 3. Vendor Selection will be based on the assessment of the vendor with respect to the vendor's capability, infrastructure, & experience in producing the proposed parts. 4. URSC team may conduct on-site visit to assess the vendor's capability & infrastructure.	
E	GENERAL INFORMATION ON INDIGENISATION FLOW TO VENDORS The Indigenization at URSC is carried out in phased manner is depicted in Annexure-3 which is just an indicative flow of activities. The following are the phases involved: 1. Phase-1: Inviting Expression of Interest (EoI) from Vendors 2. Phase-2: Proto development by Vendor (Shortlisted in Phase-1 after EoI evaluation), proto submission to URSC & evaluation of prototypes by URSC 3. Phase-3: Production, Screening & Qualification of Indigenous parts by vendors (who's proto is declared successful in Phase-2) 4. Phase-4: Procurement of Indigenous parts from qualified & approved vendors for on-board applications Qualification of Inductors needs efforts from Vendor & URSC, hence vendor is expected to maintain the production facility at least for 5 years after qualification for uninterrupted supply of space grade devices	
F	LIST OF ENCLOSURES 4. Annexure-1: RF coil and chip inductor details 5. Annexure-2: Vendor Details Form 6. Annexure-3: Flow of Indigenization Activity	

ANNEXURE-1
RF Coil and Chip Inductor Details

Annexure-1: RF coil & Chip Inductor Specification

SI No	Description	Value	Tolerance	Rated DC Current	Detailed Mil datasheet
1	Chip Inductor	0.15 uH	10%	745mA	MIL-PRF-83446/04
2	Chip Inductor	0.18 uH	10%	695mA	MIL-PRF-83446/04
3	Chip Inductor	0.22 uH	10%	665mA	MIL-PRF-83446/04
4	Chip Inductor	1 uH	10%	425mA	MIL-PRF-83446/04
5	Chip Inductor	1 uH	10%	190mA	MIL-PRF-83446/05
6	Chip Inductor	1.2 uH	10%	180mA	MIL-PRF-83446/05
7	Chip Inductor	1.5 uH	10%	160mA	MIL-PRF-83446/05
8	Chip Inductor	10 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/05
9	Chip Inductor	10 uH	10%	87mA	MIL-PRF-83446/05
10	Chip Inductor	100 nH	10%	470mA	MIL-PRF-83446/05
11	Chip Inductor	120 nH	10%	470mA	MIL-PRF-83446/05
12	Chip Inductor	15 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/05
13	Chip Inductor	150 nH	10%	450mA	MIL-PRF-83446/05
14	Chip Inductor	18 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/05
15	Chip Inductor	180 nH	10%	430mA	MIL-PRF-83446/05
16	Chip Inductor	2.2 uH	10%	140mA	MIL-PRF-83446/05
17	Chip Inductor	2.7 uH	10%	130mA	MIL-PRF-83446/05
18	Chip Inductor	22 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/05
19	Chip Inductor	270 nH	10%	310mA	MIL-PRF-83446/05
20	Chip Inductor	3.3 uH	10%	120mA	MIL-PRF-83446/05
21	Chip Inductor	3.9 uH	10%	110mA	MIL-PRF-83446/05
22	Chip Inductor	33 nH	10%	640mA	MIL-PRF-83446/05
23	Chip Inductor	330 nH	10%	280mA	MIL-PRF-83446/05
24	Chip Inductor	39 nH	10%	600mA	MIL-PRF-83446/05
25	Chip Inductor	390 nH	10%	240mA	MIL-PRF-83446/05
26	Chip Inductor	47 nH	10%	550mA	MIL-PRF-83446/05
27	Chip Inductor	470 nH	10%	230mA	MIL-PRF-83446/05
28	Chip Inductor	68 nH	10%	480mA	MIL-PRF-83446/05
29	Chip Inductor	680 nH	10%	210mA	MIL-PRF-83446/05
30	Chip Inductor	82 nH	10%	470mA	MIL-PRF-83446/05
31	Chip Inductor	1 uH	10%	200mA	MIL-PRF-83446/13
32	Chip Inductor	1.2 uH	10%	200mA	MIL-PRF-83446/13
33	Chip Inductor	1.5 uH	10%	190mA	MIL-PRF-83446/13
34	Chip Inductor	1.8 uH	10%	185mA	MIL-PRF-83446/13
35	Chip Inductor	10 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/13
36	Chip Inductor	10 uH	10%	105mA	MIL-PRF-83446/13
37	Chip Inductor	100 nH	10%	460mA	MIL-PRF-83446/13
38	Chip Inductor	12 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/13
39	Chip Inductor	120 nH	10%	455mA	MIL-PRF-83446/13
40	Chip Inductor	15 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/13
41	Chip Inductor	150 nH	10%	450mA	MIL-PRF-83446/13
42	Chip Inductor	18 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/13
43	Chip Inductor	2.2 uH	10%	180mA	MIL-PRF-83446/13

44	Chip Inductor	2.7 uH	10%	175mA	MIL-PRF-83446/13
45	Chip Inductor	22 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/13
46	Chip Inductor	27 nH	10%	750mA	MIL-PRF-83446/13
47	Chip Inductor	3.3 uH	10%	170mA	MIL-PRF-83446/13
48	Chip Inductor	3.9 uH	10%	165mA	MIL-PRF-83446/13
49	Chip Inductor	33 nH	10%	640mA	MIL-PRF-83446/13
50	Chip Inductor	330 nH	10%	280mA	MIL-PRF-83446/13
51	Chip Inductor	39 nH	10%	600mA	MIL-PRF-83446/13
52	Chip Inductor	390 nH	10%	250mA	MIL-PRF-83446/13
53	Chip Inductor	4.7 uH	10%	165mA	MIL-PRF-83446/13
54	Chip Inductor	47 nH	10%	550mA	MIL-PRF-83446/13
55	Chip Inductor	47 nH	20%	550mA	MIL-PRF-83446/13
56	Chip Inductor	470 nH	10%	230mA	MIL-PRF-83446/13
57	Chip Inductor	5.6 uH	10%	165mA	MIL-PRF-83446/13
58	Chip Inductor	56 nH	10%	520mA	MIL-PRF-83446/13
59	Chip Inductor	560 nH	10%	220mA	MIL-PRF-83446/13
60	Chip Inductor	68 nH	10%	480mA	MIL-PRF-83446/13
61	Chip Inductor	82 nH	10%	470mA	MIL-PRF-83446/13
62	Chip Inductor	820 nH	10%	200mA	MIL-PRF-83446/13
63	RF Coil , RFC MM/02	12 uH	10%	200mA	MIL-PRF-39010/02
64	RF Coil , RFC MM/03	3900 uH	5%	35mA	MIL-PRF-39010/03
65	RF Coil , RFC MM/05	10 uH	10%	440mA	MIL-PRF-39010/05
66	RF Coil , RFC MM/08	0.12 uH	10%	1270mA	MIL-PRF-39010/08
67	RF Coil , RFC MM/08	0.18 uH	10%	1105mA	MIL-PRF-39010/08
68	RF Coil , RFC MM/08	0.22 uH	10%	1025mA	MIL-PRF-39010/08
69	RF Coil , RFC MM/08	0.22 uH	5%	1025mA	MIL-PRF-39010/08
70	RF Coil , RFC MM/08	0.27 uH	10%	960mA	MIL-PRF-39010/08
71	RF Coil , RFC MM/08	0.33 uH	10%	815mA	MIL-PRF-39010/08
72	RF Coil , RFC MM/08	0.39 uH	10%	700mA	MIL-PRF-39010/08
73	RF Coil , RFC MM/08	0.47 uH	10%	650mA	MIL-PRF-39010/08
74	RF Coil , RFC MM/08	0.56 uH	10%	545mA	MIL-PRF-39010/08
75	RF Coil , RFC MM/08	0.82 uH	10%	415mA	MIL-PRF-39010/08
76	RF Coil , RFC MM/08	1 uH	10%	385mA	MIL-PRF-39010/08
77	RF Coil , RFC MM/09	1.2 uH	10%	590mA	MIL-PRF-39010/09
78	RF Coil , RFC MM/09	1.5 UH	10%	535mA	MIL-PRF-39010/09

79	RF Coil , RFC MM/09	1.8 uH	10%	455mA	MIL-PRF-39010/09
80	RF Coil , RFC MM/09	10 uH	10%	130mA	MIL-PRF-39010/09
81	RF Coil , RFC MM/09	15 uH	10%	150mA	MIL-PRF-39010/09
82	RF Coil , RFC MM/09	2 uH	5%	395mA	MIL-PRF-39010/09
83	RF Coil , RFC MM/09	2.2 uH	10%	395mA	MIL-PRF-39010/09
84	RF Coil , RFC MM/09	2.7 uH	10%	335mA	MIL-PRF-39010/09
85	RF Coil , RFC MM/09	22 uH	10%	140mA	MIL-PRF-39010/09
86	RF Coil , RFC MM/09	27 uH	10%	135mA	MIL-PRF-39010/09
87	RF Coil , RFC MM/09	3.3 uH	10%	270mA	MIL-PRF-39010/09
88	RF Coil , RFC MM/09	3.9 uH	10%	250mA	MIL-PRF-39010/09
89	RF Coil , RFC MM/09	4.7 uH	10%	230mA	MIL-PRF-39010/09
90	RF Coil , RFC MM/09	6.8 uH	10%	175mA	MIL-PRF-39010/09
91	RF Coil , RFC MM/10	100 uH	10%	84mA	MIL-PRF-39010/10
92	RF Coil , RFC MM/10	47 uH	10%	110mA	MIL-PRF-39010/10
93	RF Coil , RFC MM/10	68 uH	10%	92mA	MIL-PRF-39010/10
94	RF Coil , RFC SM/05	10 uH	10%	440mA	MIL-PRF-39010/05

ANNEXURE-2
VENDOR DETAILS FORM

Annexure-2: Vendor Details Form

1. Name & Address of the Vendor:
2. Website of the vendor if any:
3. Year of Establishment:
4. Is the company Startup / MSME:
5. Vendor: Manufacturer/Supplier
6. Plant Area:
7. Components Type Manufactured:
8. Details of Manufacturer's production: Continuous/Limited
9. Details of the Infrastructure (List of Major Production & Testing Equipment's)
10. List of major Customers:
11. List of Aerospace & Defence Customers (if any):
12. Component development status: Developed/To be developed
13. Time line for proto submission (if to be developed)
14. Provide PID (if available)
15. Availability of equipment & Technology to develop the component: Yes/No
16. Quality Management System Certification details if any (ISO/AS Standard):
17. Lab Environment / Cleanliness level (if available):
18. ESD Compliance (Standard) (if available):
19. Is the Facility used for commercial products and Aerospace Defence & Space is the same?

Note: Provide Documentary Proof as supporting documents & third-party certificate, if available

Signature:

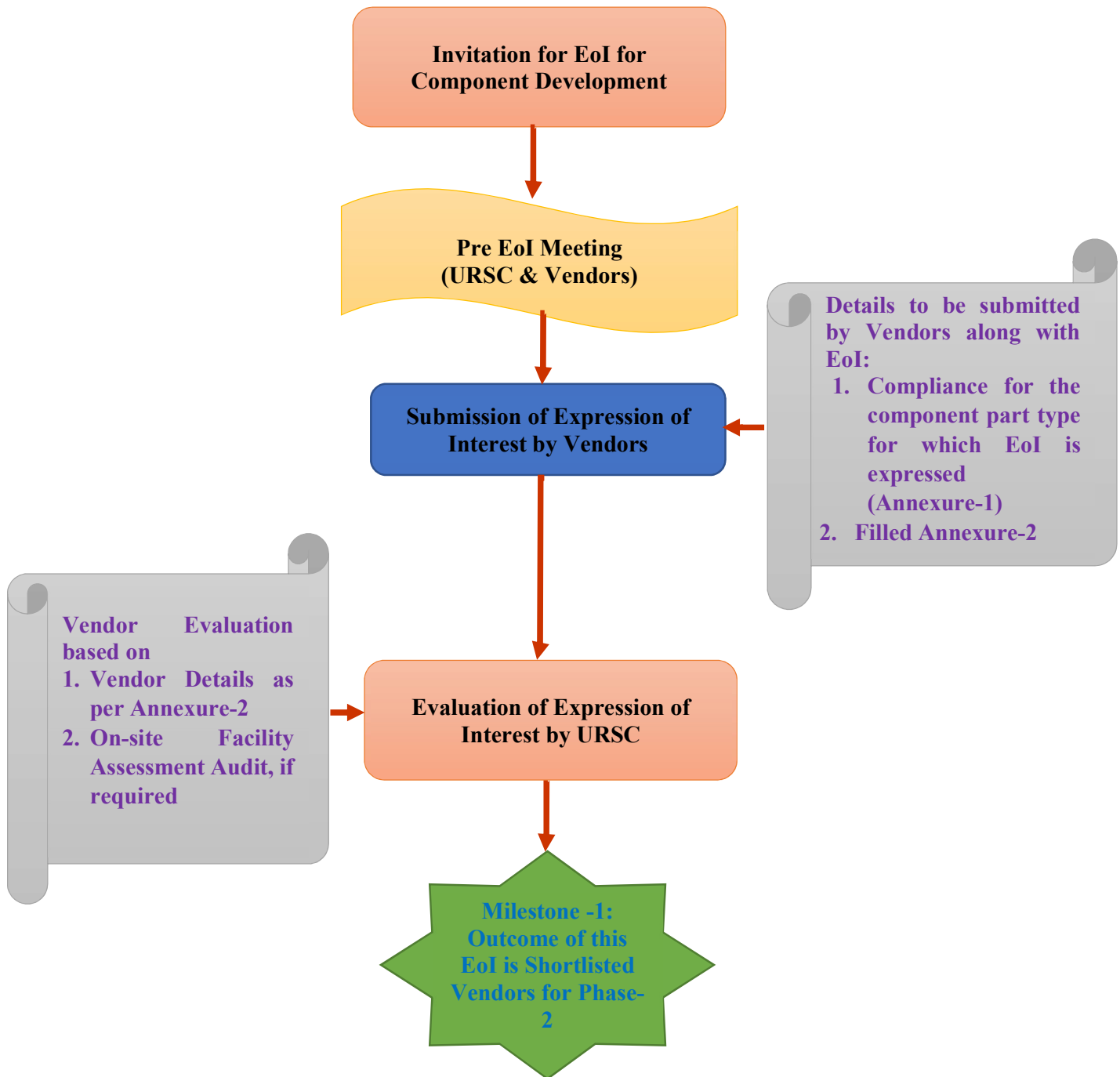
Name of the authorized signatory for the company:

Date:

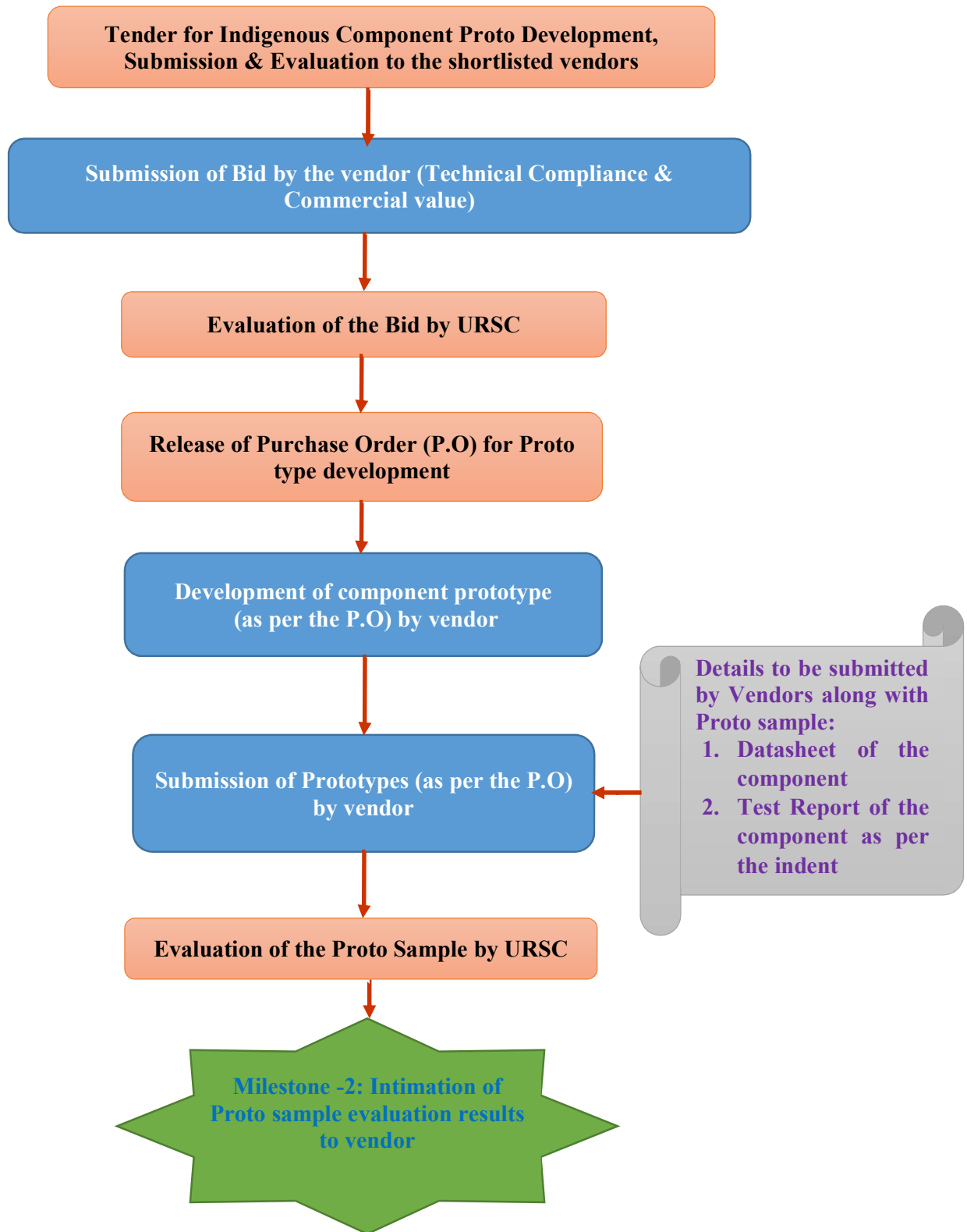
Place:

ANNEXURE-3
FLOW OF INDIGENISATION

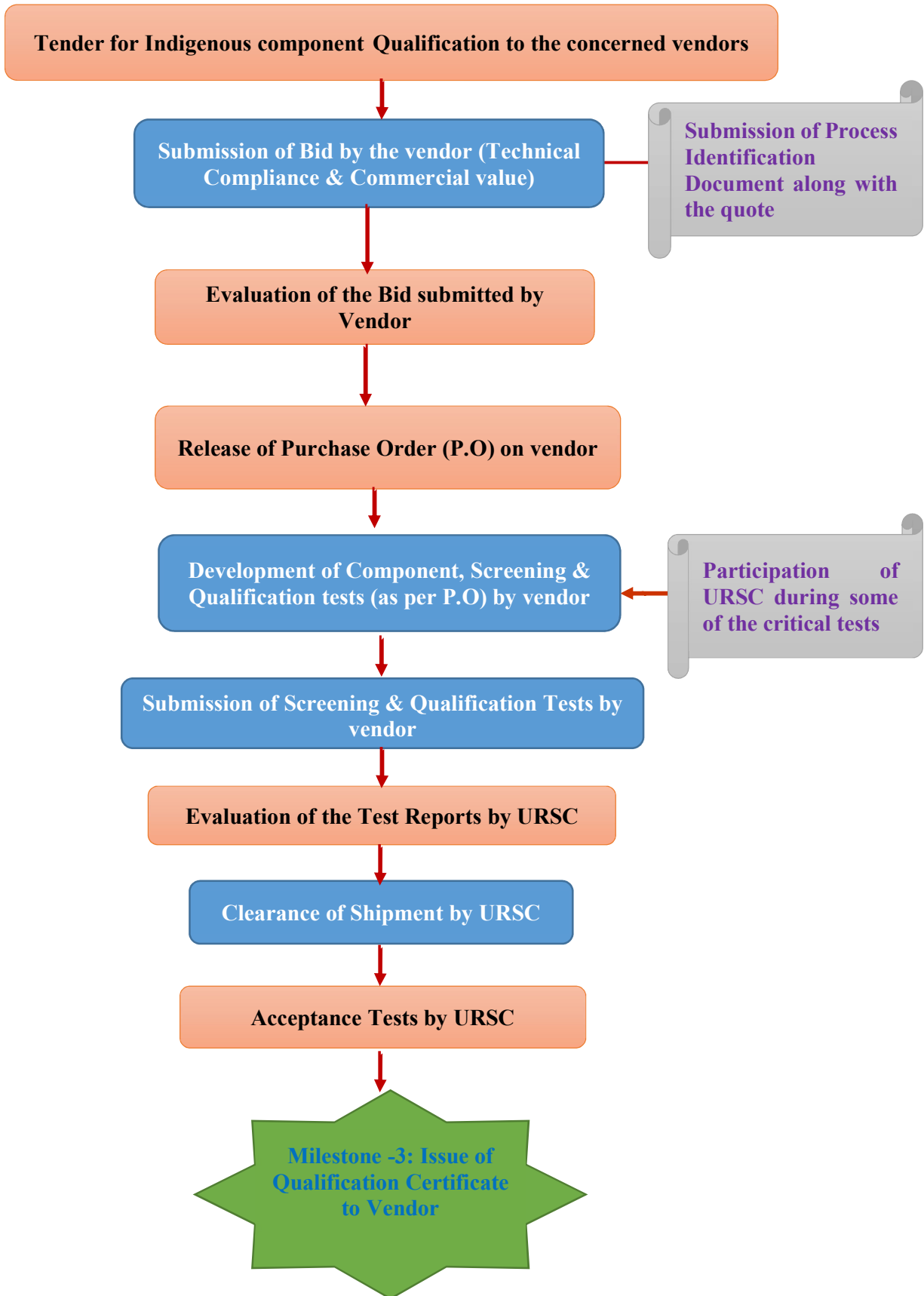
Phase-1: Inviting Expression of Interest (EoI)



Phase-2: Component Prototype Development, Submission & Evaluation Flow



Phase-3: Component Qualification Flow



Phase-4: Procurement of component for On-board Applications

